

AN 1993:8130 CAPLUS
 DN 118:8130
 ED Entered STN: 10 Jan 1993
 TI Moisture- and heat-resistant resin sealing compositions and sealed semiconductor devices
 IN Sawai, Kazuhiro; Kokubo, Masanori
 PA Toshiba Chemical Corp., Japan
 SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 5 pp.
 CODEN: JKXXAF
 DT Patent
 LA Japanese
 IC ICM C08G059-20
 ICS C08G059-62; C08K003-00; C08L063-00; H01L023-29; H01L023-31
 CC 38-3 (Plastics Fabrication and Uses)
 Section cross-reference(s): 76

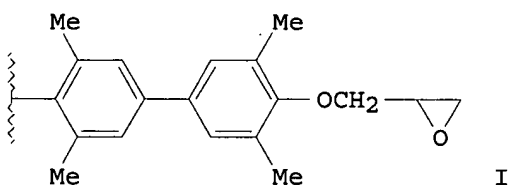
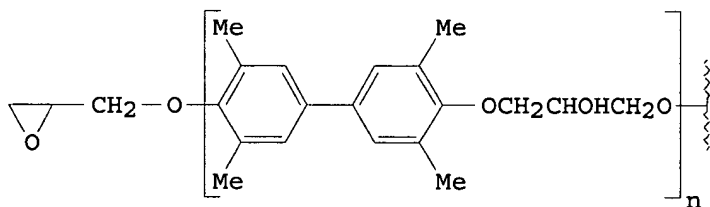
FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	JP 04236215	A2	19920825	JP 1991-15846	19910116
PRAI	JP 1991-15846		19910116		

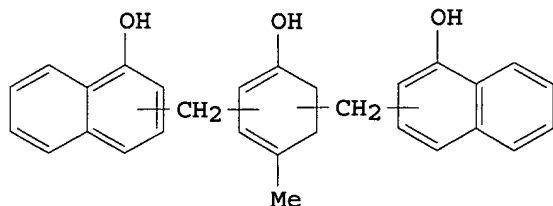
CLASS

PATENT NO.	CLASS	PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
JP 04236215	ICM	C08G059-20
	ICS	C08G059-62; C08K003-00; C08L063-00; H01L023-29; H01L023-31
	IPCI	C08G0059-20 [ICM,5]; C08G0059-62 [ICS,5]; C08K0003-00 [ICS,5]; C08L0063-00 [ICS,5]; H01L0023-29 [ICS,5]; H01L0023-31 [ICS,5]

GI



I



II

AB The title semiconductor devices are manufactured by sealing semiconductor elements with cured products of compns. containing epoxy resins I ($n \geq 0$), phenolic resins containing naphthol structures and 25-90% (based on the compns.) inorg. fillers. Thus, a semiconductor devices sealed with a composition containing I ($n = 0$) 17,

II-containing phenolic resins 10, powdered silica 72, a crosslinking accelerator 0.3, an ester wax 0.3, and a silane coupling agent 0.4% showed good moisture and solder heat resistance.

ST epoxy resin sealant semiconductor; naphthol phenolic resin crosslinker epoxy; heat resistance epoxy resin sealant; moisture resistance epoxy resin sealant

IT Epoxy resins, uses
 RL: USES (Uses)
 (sealing compns. containing naphthol-based phenolic resins and, for semiconductor devices, with good heat and moisture resistance)

IT Potting compositions
 (heat-resistant, epoxy resins containing naphthol-based phenolic resins and inorg. fillers, for semiconductor devices)

IT Phenolic resins, uses
 RL: MOA (Modifier or additive use); USES (Uses)
 (naphthol-based, crosslinking agents, for epoxy resins, for sealants, for semiconductor devices, with good heat and moisture resistance)

IT 7631-86-9, Silica, uses
 RL: USES (Uses)
 (powdered, fillers, for epoxy resin sealing compns., for semiconductor devices)

IT 85954-11-6DP, polymers with phenolic resins
 RL: PREP (Preparation)
 (preparation of, sealants, for semiconductor devices, with good moisture and heat resistance)

DERWENT-ACC-NO: 1992-328240

DERWENT-WEEK: 199240

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Sealing resin compsn. for semiconductor- consists of epoxy! resin, phenol! resin and inorganic filler, has high moisture and soldering resistance

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA CHEM CORP[TOSM]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0015846 (January 16, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAINIPC
<u>JP 04236215 A</u>	August 25, 1992	N/A	05	C08G 059/20

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 04236215A	N/A	1991JP0015846	January 16, 1991

INT-CL (IPC): C08G059/20, C08G059/62 , C08K003/00 , C08L063/00 , H01L023/29 , H01L023/31

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04236215A

BASIC-ABSTRACT:

A sealing compsn. comprises mianly (A) epoxy resin of formula (I), where n is 0 or an integer, (B) phenol resin having naphtholskeleton and (C) an inorganic filler in an amt. = 25-90 wt.% of the compsn.

Specifically (A) is independent from its mol. wt. and blended opt. with epoxy resin of novolak type or epibis type. (B) is independent from its mol. wt. and its molecular structure and is e.g. of formula (II), (III) or (IV); where n is an integer excluding 0. (C) is pref. silica powder contg. a lesser amt. impurity and having an average particle size = up to 30 microns. The compsn. is blended opt. with minor amts. of a release agent (e.g., natural wax, synthetic wax, metallic salt of linear fatty acid, acid amide, ester, paraffin, etc.), a flame-retardent (e.g., Sb2O3, etc.), a colourant (e.g., carbon black), a silane coupling agent, a hardening accelerator, a stress improver (e.g., rubber or silicone resin), etc. The resin compsn. is prepd. by formulating (A), (B), (C) and other additives, mixing through a mixer, or melt mixing through heating rolls, cooling the mixt. to solidify it and pulverising it to provide the moulding compsn. The moulding cpd. is transfer casted into a mould attached with a semiconductor element in it to harden the resin compsn. to provide semiconductor device.

USE/ADVANTAGE - The resin compsn. is used for sealing semiconductor elements, has high moisture and soldering resistance. It is hardly affected by moisture absorption and reduces markedly the disconnection due to the corrosion of electrodes and the current leakage due to the absorbed moisture.

io

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: SEAL RESIN COMPOSITION SEMICONDUCTOR CONSIST POLYEPOXIDE RESIN POLYPHENOL RESIN INORGANIC FILL HIGH MOIST SOLDER RESISTANCE

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03 U11

CPI-CODES: A05-A02; A05-C; A08-D; A08-R01; A12-E04; A12-E07C; L04-C20A;

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-236215

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 8 G 59/20	NHQ	8416-4J		
59/62	NJS	8416-4J		
C 0 8 K 3/00		7167-4J		
C 0 8 L 63/00	NKT	8416-4J		
		8617-4M		
			H 0 1 L 23/30	R

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平3-15846

(22)出願日 平成3年(1991)1月16日

(71)出願人 390022415

東芝ケミカル株式会社

東京都港区新橋3丁目3番9号

(72)発明者 沢井 和弘

埼玉県川口市領家5丁目14番25号 東芝ケ

ミカル株式会社川口工場内

(72)発明者 小久保 正典

埼玉県川口市領家5丁目14番25号 東芝ケ

ミカル株式会社川口工場内

(74)代理人 弁理士 諸田 英二

(54)【発明の名称】 封止用樹脂組成物および半導体封止装置

(57)【要約】

【構成】 この発明は、(A)4,4'-ジヒドロキシ(テトラメチルビフェニル)骨格を有するエポキシ樹脂、(B)ナフトール骨格を有するフェノール樹脂及び(C)無機質充填剤を必須成分とし、前記(C)無機質充填剤を樹脂組成物に対して25~90重量%の割合で含有してなることを特徴とする封止用樹脂組成物と、その組成物によって封止された半導体封止装置である。

【効果】 本発明の封止用樹脂組成物と半導体封止装置は、特定骨格を有するエポキシ樹脂とナフトール骨格を有するフェノール樹脂を用いることによって、樹脂組成物のガラス転移温度が上昇し、熱機械的特性と低応力性が向上し、半導体封止装置の半田浸漬、半田リフロー後の樹脂クラックの発生がなくなり耐湿性劣化が少なくなるものである。

2

3

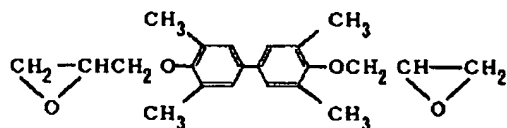
とする封止用樹脂組成物である。また、この封止用樹脂組成物の硬化物によって、半導体素子が封止されてなることを特徴とする半導体封止装置である。

【0008】以下、本発明を詳細に説明する。

【0009】本発明に用いる(A)エポキシ樹脂としては、前記の式で示されるものが使用され、分子量等に制限されることなく、広く使用することができる。例えば

【0010】

【化4】



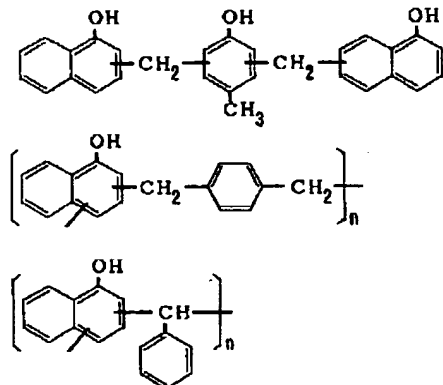
が挙げられる。また、このエポキシ樹脂にノボラック系エポキシ樹脂やエピビス系エポキシ樹脂を併用することができる。

【0011】本発明に用いる(B)ナフトール骨格を有するフェノール樹脂としては、分子構造、分子量などに特に制限されることはなく広く包含することができる。

具体的な樹脂としては、例えば

【0012】

【化5】



(但し、式中、nは1以上の整数を表す)等が挙げられる。また、フェノール、アルキルフェノール等のフェノール類とホルムアルデヒドまたはパラホルムアルデヒドとを反応させて得られるノボラック型フェノール樹脂およびこれらの変性樹脂を混合して使用することができる。

【0013】本発明に用いる(C)無機質充填剤としては、一般に使用されているものが広く使用されるが、それらの中でも不純物濃度が低く、平均粒径30μm以下のシリカ粉末が好ましく使用される。平均粒径が30μmを超えると耐湿性および成形性が劣り好ましくない。無機質充填剤の配合割合は、全体の樹脂組成物に対して50~90重量%含有することが好ましい。その割合が50重量%未満では樹脂組成物の吸湿性が高く、半田浸漬後の耐湿性に劣り、また90重量%を超えると極端に流動性が悪く

4

なり成形性に劣り好ましくない。

【0014】本発明の封止用樹脂組成物は、前述した特定のエポキシ樹脂、ナフトール骨格を有するフェノール樹脂および無機質充填剤を必須成分とするが、本発明の目的に反しない限度において、また必要に応じて、例えば天然ワックス類、合成ワックス類、直鎖脂肪酸の金属塩、酸アミド、エステル類、パラフィンなどの離型剤、三酸化アンチモンなどの難燃剤、カーボンブラックなどの着色剤、シランカップリング剤、種々の硬化促進剤、ゴム系やシリコン系の低応力付与剤等を適宜添加・配合することができる。

【0015】本発明の封止用樹脂組成物を成形材料として調製する場合の一般的方法は、前述のエポキシ樹脂、ナフトール骨格を有するフェノール樹脂および無機質充填剤その他を配合し、ミキサー等によって十分均一に混合した後、さらに熱ロールによる熔融混合処理又は二ダ等による混合処理を行い、次いで冷却固化させ適当な大きさに粉砕して成形材料とすることができる。この成形材料を用いて半導体素子をセットした金型内にトランスファー注入して硬化させて本発明の半導体装置を製造することができる。成形材料は半導体素子の封止の他に電子部品、あるいは電気部品の封止また被覆・絶縁等にも使用することができ、それらに優れた特性を付与することができる。

【0016】

【作用】本発明の封止用樹脂組成物は、特定のエポキシ樹脂とナフトール骨格を有するフェノール樹脂を用いることによって、樹脂組成物のガラス転移温度が上昇し、熱機械的特性と低応力性が向上し、半田浸漬、半田リフロー後の樹脂クラックの発生がなくなり耐湿性劣化が少なくなるものである。

【0017】

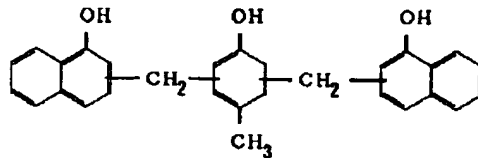
【実施例】次に本発明の実施例について説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。以下の実施例および比較例において「%」とは「重量%」を意味する。

【0018】実施例1

前述した化4で示される特定のエポキシ樹脂17%、次式に示したナフトール骨格を有するフェノール樹脂10%

【0019】

【化6】



シリカ粉末72%、硬化促進剤 0.3%、エステルワックス 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を常温で混合し、さらに90~95℃で混練し、冷却した後、粉砕して成

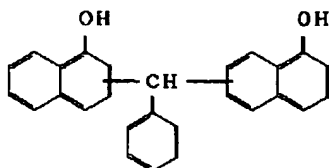
形材料 (A) を製造した。

【0020】実施例2

実施例1で用いたエポキシ樹脂17%および次式で示したナフトール骨格を有するフェノール樹脂10%、

【0021】

【化7】



シリカ粉末72%、硬化促進剤 0.3%、エステルワックス 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を常温で混合し、さらに90~95℃で混練冷却した後、粉碎して成形材料 (B) を製造した。

【0022】比較例1

オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂17%、ノボラック型フェノール樹脂 8%、シリカ粉末74%、硬化促*

*進剤 0.3%、エステル系ワックス 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を混合し、実施例1と同様にして成形材料 (C) を製造した。

【0023】比較例2

エビス型エポキシ樹脂 (エポキシ当量450) 20%、ノボラック型フェノール樹脂 5%、シリカ粉末74%、硬化促進剤 0.3%、エステル系ワックス 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を混合し、実施例1と同様にして成形材料 (D) を製造した。

10 【0024】こうして製造した成形材料 (A) ~ (D) を用いて 170℃に加熱した金型内にトランスファー注入し、硬化させて半導体素子を封止した半導体装置を製造した。これらの半導体装置の諸特性を試験したのでその結果を表1に示したが、本発明の封止用樹脂組成物および半導体装置は耐湿性、半田耐熱性に優れており、本発明の顕著な効果を確認することができた。

【0025】

【表1】 (単位)

特性	例 1	例 2	比較例 1	比較例 2
成形材料	A	B	C	D
吸水率 (%) *1	0.30	0.45	0.60	0.64
ガラス転移温度 (℃) **	159	171	160	135
曲げ強さ (kgf/mm ²) **				
常温	14.4	13.8	14.2	13.1
220℃	2.3	3.1	2.0	1.5
半田浴浸漬後のPCT*4 (不良数/サンプル数)				
20H	0/20	0/20	0/20	0/20
40H	0/20	0/20	5/20	0/20
100H	0/20	0/20	20/20	1/20
200H	0/20	0/20	—	1/20
300H	0/20	0/20	—	20/20
400H	0/20	0/20	—	—
500H	2/20	2/20	—	—
半田リフロー後の 樹脂クラック*5 (不良数/サンプル数)	0/12	0/12	12/12	12/12

*1 : トランスファー成形によって直径50mm、厚さ 3mmの成形品を作り、これを 127℃、2.5気圧の飽和水蒸気中に24時間放置し、増加した重量によって測定した

*2 : 吸水率の場合と同様な成形品を作り、175℃で8時間の後硬化を行い、適当な大きさの試験片とし、熱機械分析装置を用いて測定した

*3 : JIS-K-6911に準じて試験した

*4 : 成形材料を用いて、2本以上のアルミニウム配線

を有するシリコン製チップを、通常の42アロイフレームに接着し、175℃で2分間トランスファー成形した後、175℃、8時間後硬化を行った。こうして得た成形品を予め、40℃、90%RH、100時間の吸湿処理した後、250℃の半田浴に10秒間浸漬した。その後、127℃、2.5気圧の飽和水蒸気中でプレッシャークッカーテストを行い、アルミニウムの腐食による断線を不良として評価した

7

8

*5 : 8×8 mmダミーチップをQFP (14×14×1.4 mm) パッケージに納め、成形材料を用いて 175℃で 2 分間トランスファー成形した後、175℃、8時間後硬化を行った。こうして製造した半導体装置を85℃、85%、24時間の吸湿処理をした後 240℃の半田浴に 1分間浸漬した。その後、実体顕微鏡でパッケージ表面を観察し、外部樹脂クラックの発生の有無を評価した。

【0026】

【発明の効果】以上の説明および表1から明らかなように、本発明封止用樹脂組成物および半導体装置は、耐湿性、半田耐熱性に優れ、吸湿による影響が少なく、電極の腐食による断線や水分によるリーク電流の発生などを著しく低減することができ、しかも長期間にわたって信頼性を保証することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁵

識別記号

片内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 23/29

23/31